

國立臺北藝術大學

結晶型游離二氧化矽報告書

報告編號：G261110104

監測日期：111年01月04日

監測機構：工安興業股份有限公司

認可編號：TOSHA-MA13

工安興業股份有限公司
勞動部作業環境監測機構
TOSHA-MA13
報告專用章



鑒威矽綿檢驗科技有限公司

TopLab Silibestos Advanced Detection Technology Co., Ltd



分析報告

報告編號：JW(S)1110114-002

檔案編號：11101-002

監測日期：111年01月04日

收樣日期：111年01月06日

報告日期：111年01月14日

委託編號：G261110104

委託單位：工安興業股份有限公司

委託地址：111 台北市士林區中山北路七段56號1樓

受測單位：國立台北藝術大學

執行單位：鑒威矽綿檢驗科技有限公司

單位地址：彰化市師大路2號力行館31B06室

電話：0928-870330

認證編號：3814

認證類別：游離二氧化矽等礦物性粉塵分析

認可期限：110年02月23日至113年02月22日

實驗室主任：施慧中

111年01月14日

報告簽署人：施慧中

111年01月14日

保存期限：10 年

報告頁數：6 頁





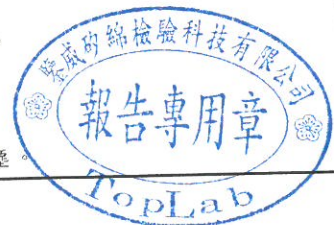
分析報告

說明：

- 一、本報告為符合勞工作業環境監測實施辦法所出具之分析報告。
- 二、本報告所用樣品及名稱均由委託單位所提供，本實驗室僅負責分析，對樣品分析結果不做符合性之判定，亦不對報告提出意見與解釋。
- 三、本實驗室結果報告乃依據送樣單位所提供之資料，若因送樣單位提供給本實驗室樣品資訊之不完整、不正確等而產生不正確之結果本實驗室不負有責任，包括任何間接或其他衍性之損失、傷害或賠償，本實驗室亦不負責。
- 四、因執行試驗所得之資料、圖表及檢驗報告，雙方均應負有保密之責，非經由雙方書面同意，不得交與第三者，否則須接受法律制裁與賠償。本報告未經本實驗室同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 五、採樣日期及現場樣本相關資料係由送樣單位提供。
- 六、空氣中濃度值係由實驗室分析結果，並根據採樣單位提供之採樣體積換算而得。
- 七、如有現場空白樣本，介質空白樣本及原料樣本等將於報告中註明。
- 八、採樣後經校正之體積係指換算成25°C，一大氣壓後之採樣體積。
- 九、如有樣本圖譜之資料，則提供圖譜影印資料。
- 十、備註中“註1”意指採樣體積未在採樣分析建議方法範圍內。
“註2”意指採樣流率未在採樣分析建議方法範圍內。
“註3”意指粉塵樣本有超過濾紙負載量。
- 十一、我國勞工作業環境空氣中粉塵容許濃度：

種類	粉塵	容許濃度		符號
		可呼吸性粉塵	總粉塵	
第一種粉塵	含結晶型游離二氧化矽 10%以上之礦物性粉塵	10mg/m ³ %SiO ₂ +2	30mg/m ³ %SiO ₂ +2	
第二種粉塵	含結晶型游離二氧化矽未滿 10%之礦物性粉塵	1mg/m ³	4mg/m ³	
第三種粉塵	石棉纖維	0.15 f/c.c.		瘤
第四種粉塵	厭惡性粉塵	5mg/m ³	10mg/m ³	

註：1. 本表內所規定之容許濃度均為八小時日時量平均容許濃度。
2. 可呼吸性粉塵係指可透過離心式等分粒裝置所測得之粒徑者。
3. 總粉塵係指未使用分粒裝置所測得之粒徑者。
4. 結晶型游離二氧化矽係指石英、方矽石、鱗矽石及矽藻土。
5. 石棉粉塵係指纖維長度在五微米以上，長寬比在三以上之粉塵。





分析報告

1. 結果數據

檔案編號：11101-002
 委託編號：G261110104
 委託單位：工安興業股份有限公司
 受測機構：國立台北藝術大學
 分析項目：結晶型游離二氧化矽(SiO₂)

監測日期：111年01月04日
 現場溫壓：18°C;767mmHg
 收樣日期：111年01月06日
 分析日期：111年01月10日
 檢量下限：0.03 mg/sample

分析方法：參考4003(勞),4004(勞),JIS A1481(2008)，自訂方法：JW-SOP-001

樣品編號 (監測編號)	監測處所	粉塵重量 (mg)	SiO ₂ 重量 (mg)	SiO ₂ 含量 (%)	採樣流速 (mL/min)	採樣時間	校正後 採樣體積 (L)	空氣中 濃度 (mg/m ³)	容許 暴露標準 (mg/m ³)	備註
Si1110106-005 (H29)	美術學系/石雕教室	0.03	<0.030	<10.00	起:2002 迄:2000 平均:2001	08:35~ 14:52 (377min)	779.7	0.038	4.000	總粉塵
Si1110106-006 (BK01)	現場空白	<0.03	<0.030	-	-	-	-	-	-	總粉塵
Si1110106-007 (BK02)	現場空白	<0.03	<0.030	-	-	-	-	-	-	總粉塵
-以下空白-										

